

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

广东汇成真空科技股份有限公司

Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd.

（广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号）



**2026年度向特定对象发行A股股票
方案论证分析报告**

二〇二六年八月

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”“汇成真空”或“发行人”）为在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过 95,500.00 万元，扣除发行费用后将用于：1、“超精密半导体及连续式 PVD 设备产业化项目”，以实现超精密光学镀膜设备、TGV 微孔镀膜设备、连续式镀膜设备等 PVD 设备的产能储备；2、补充公司主营业务所需流动资金。

如无特别说明，本论证分析报告中简称和术语与《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、半导体行业高速发展叠加国家政策支持，产业链本土化全链条供给成为必然趋势

半导体行业是现代经济社会发展的先导性、战略性产业，是电子信息产业的基石。随着半导体产业技术进步、加工能力提升，以及下游市场需求扩大，全球及中国半导体市场近年来呈现显著增长态势。根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2018年至2025年全球半导体市场规模从4,688亿美元增长至7,917亿美元，年均复合增长率达7.77%；按中国半导体行业协会统计和预测，我国半导体产业销售额从2018年的9,190亿元扩大至2025年的21,367.7亿元，年均复合增长率高达12.81%。未来，在助力传统产业转型升级的同时，随着AI算力、智能终端、工业自动化、机器人、新能源与储能等新兴领域的蓬勃发展，作为底层技术支撑的半导体产业将保持高速增长势头。

作为全球电子产品制造大国及主要消费市场，中国电子信息产业持续快速发展，全球地位迅速提升，为中国半导体产业发展提供良好机遇，已初步形成芯片设计、晶圆制造、封装测试的半导体全产业链。但半导体产业链关键领域

的“卡脖子”瓶颈、尚未完善的产业链协同生态，导致我国半导体产业在一些核心环节与欧美日韩等发达地区存在差距，高端芯片和半导体设备仍主要依赖进口。与此同时，国际地缘政治冲突、贸易争端频发、海外对华半导体出口管制，加剧高端半导体材料全球供应链的不确定性。在此背景下，提高半导体产业链的安全性和稳定性、打造半导体产业本土化全链条供给体系刻不容缓。

目前，我国政策端已将半导体产业提升至国家战略安全高度。2026年3月，“十五五规划纲要”明确提出，聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；2024年9月，《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》明确将集成电路生产装备、测量检测装备等列入重大技术装备名单，以促进重点技术装备的创新发展和推广应用，提升我国装备制造业的核心竞争力；2022年12月，《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提出全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路等技术创新和应用。产业“大基金”等国家资本与其他产业资本陆续向设备、材料、制造、设计、封装等产业链头部企业提供资源支持。

鼓励研发投入、完善产业生态、引入产业投资基金与政策支持多措并举，为半导体产业自主化升级进程形成强大助推力，引领境内半导体技术从“全面追赶”转向“重点突破”，加速本土技术自主创新的拐点到来，这也为境内半导体产业链相关设备企业的经营发展注入动力。

2、半导体核心设备国产化和其他下游行业需求提升为PVD设备应用开辟广阔空间

（1）半导体产业链

半导体产业链主要涵盖上游原材料与设备，中游芯片设计、晶圆制造与封装测试三大核心环节，下游应用终端。半导体专用设备作为产业链上游的关键支撑环节，是完成晶圆制造和封装测试的基础，在半导体产业链中具有极高的战略价值和产业地位。

在晶圆制造环节，光刻设备、刻蚀机和薄膜沉积设备是核心设备。其中，光刻设备用于将电路图案转移到硅晶圆上，是决定芯片制程先进程度的关键因

素。依据所使用的光源类型和技术水平，光刻设备可分为可见光光刻设备、紫外光光刻设备、深紫外光刻设备、极紫外光刻设备等。深紫外光刻设备是目前主流的光刻设备之一，广泛用于主要成熟芯片制程，通过浸没式光刻与多重曝光技术结合，深紫外光刻设备可探索制造出7nm制程的先进芯片。2024年，我国在深紫外光刻技术领域实现突破，研发的国产KrF及ArF光刻设备已被列入首台（套）推广目录，境内对深紫外光刻设备产业化的部署让光刻应用逐步由境外垄断转为境内外共同发展；极紫外光刻设备则是制造7nm及以下先进制程芯片的关键设备，能显著提升芯片性能和集成度，是现阶段最尖端的光刻技术。紫外光刻设备将逐步实现本土化发展，境内厂商和科研院所正在加紧部署深紫外光刻设备技术开发和本土供应链搭建，境内极紫外光刻设备整体处于研究开发阶段，多家厂商及科研机构正积极研发整机或关键零部件，推动其产业化落地。

光刻设备整机研发、制造复杂，其中的投影物镜系统及其超精密光学元器件是影响光刻设备核心参数的主要组件。超精密光学元器件的光学膜能够调控光线透射、反射特性，有效降低散射损耗、消除杂光并减小像差，进而优化元器件的光学性能，这类光学膜对真空镀膜设备在膜层厚度、均匀性等方面提出更高镀膜技术要求。过去，光刻设备超精密光学元器件的镀膜需求主要由境外真空镀膜核心厂商满足，境内庞大存量深紫外光刻设备的关键配件有较大的本土化供应需求，加上境内半导体光刻设备开发工作不断推进，二者共同推动境内超精密光学元器件企业不断自我突破，而该过程离不开国产真空镀膜设备的技术支撑与工艺保障。

芯片封装按工艺可分为传统封装和先进封装（包括倒装封装、晶圆级封装以及三维堆叠封装等）。当前半导体制程工艺逐渐逼近物理极限，业内开始寻求通过先进封装技术提升芯片整体性能，助力半导体产业“超越摩尔定律”，由此将催生对先进封装工艺相关设备的增量需求。

TGV归属于三维堆叠封装技术，是在玻璃基板上制造通孔并进行金属化处理的技术，相较于TSV技术使用的硅基板，玻璃基板凭借低损耗、高线性度以及优异的高频特性等优势，更适应高速信号互连的应用需求。TGV工艺通过垂直的电气互连通道，能够实现芯片在三维空间的高密度堆叠与集成，是芯片制

程微缩技术制约下业界对先进制程芯片突破研发限制的一条重要路径。由于玻璃基板不具备导电性，TGV封装要先在玻璃基板的微孔表面沉积一层粘附层，以对玻璃形成强力的机械互锁和化学键合，再镀上导电层，为后续电镀填充铜打下基础。玻璃微孔镀膜对台阶覆盖率、拉拔力及附着力等指标提出严格要求，公司TGV微孔镀膜技术可以解决深径比大于15:1的通孔全覆盖镀膜、铜与玻璃材料粘附的难题，因此，TGV微孔镀膜设备是确保基板内芯片之间和基板上下层进行高速信号传输，实现更高芯片集成度，助力芯片先进封装工艺迭代发展的关键前提。TGV工艺还可应用于RF射频前端模组、光-电共封装、MicroLED等应用场景。目前算力、存力需求快速攀升，拉动全球玻璃基板市场步入增长新周期，境内厂商正积极追赶国际先进水平，部分境内企业已成功研制TGV玻璃基板并向下游客户送样，有望推进商业化进程，预期相关配套的TGV微孔镀膜等关键设备将受益。

综上，境内半导体产业技术进步对真空镀膜技术提出更高要求，而真空镀膜技术的升级迭代能促进境内半导体产业不断发展，二者相辅相成，驱动产业生态协同进步。目前，境外PVD镀膜设备厂商在配套超精密光学元器件和先进封装TGV工艺的研发、生产中处于优势地位，而半导体产业链本土化全链条供给的背景则为境内PVD镀膜设备厂商提供了良好的发展机遇。

（2）其他下游行业

连续式镀膜设备是一种在真空环境下，使镀膜源在整个生产过程中保持不间断工作状态的自动化镀膜系统。公司连续式镀膜设备自动化程度较高，普遍采用模块化设计思路，通过多工艺模块串联与自动化传输系统结合，从而实现从进料、前处理、镀膜到后道的全流程连续化作业，有效提升生产效率，降低能耗，确保高精度的膜厚控制和膜层质量，能够适配公司下游客户多样化的应用场景。受益于消费电子、汽车、新能源等下游行业对连续式生产需求的持续提升，公司连续式镀膜设备产品应用范围将得到扩大。

3、公司深耕真空镀膜领域，具有深厚的技术积累和强大的创新实力，并积极在半导体等应用领域进行布局

公司以真空镀膜技术为核心，长期致力于磁控溅射镀膜技术、蒸发镀膜技

术、离子镀膜技术等真空镀膜技术的研究和应用。在人员配备上，公司已拥有具备持续创新能力的技术团队和管理队伍，在核心技术方面，公司已掌握真空腔体、温控系统、电弧蒸发源、磁控溅射阴极、离子源、自动控制系统等关键模块的自主研发能力，并搭建覆盖多类膜系的研发试验平台，能够为客户提供定制化的镀膜装备设计、制造及工艺解决方案。

公司深刻意识到半导体产业链对我国现代经济发展的战略地位，积极布局半导体设备高端应用领域的镀膜技术研发和储备，持续攻关超高真空技术、超高真空和高温环境下的高精度及高速运动控制、高深径比微孔内壁镀膜、静态磁控溅射镀膜等核心技术，已具备超精密光学镀膜设备、TGV微孔镀膜设备等PVD设备的产业化能力。目前公司已陆续向部分高校、科研院所及已在以上相关产业布局的核心企业交付少量超精密光学镀膜设备、TGV微孔镀膜设备，但相应产品的量产供应能力亟需提升。

基于现有技术及工艺积累，公司已持续向客户供应连续式镀膜设备产品，在消费电子、汽车、新能源等产业的竞争力得到强化，然而，面对下游行业对连续式镀膜产品的切实需求，公司亦需通过建设新场地以进一步提升该类产品的产能保障能力。

（二）本次发行股票的目的

1、满足超精密光学元器件与先进封装技术对PVD设备的升级需求，响应半导体产业链本土化全链条供给的国家战略

当前，超精密光学领域镀膜设备主要依赖境外厂商供应，在全球地缘政治冲突加剧、国际贸易争端频发、国产半导体光刻设备开发持续取得突破、境内存量光刻设备关键零配件维保替换需求日益凸显的背景下，解决超精密光学元器件镀膜设备国产化供应已成为当务之急。与此同时，我国TGV先进封装工艺发展迅速，境内先进封装厂商愈发倾向于与具备技术实力的国产镀膜设备供应商开展深度合作，以应对前沿封装技术挑战。因此，要实现超精密光学元器件与前沿先进封装技术的突破，离不开国产PVD设备的技术支撑与工艺保障。

报告期内，公司凭借已有技术工艺积累，开发适配半导体超精密光学元器件和先进封装工艺对镀膜环节要求的PVD设备。公司本次募集资金投资项目旨

在形成超精密光学镀膜设备、TGV微孔镀膜设备等PVD设备的自主生产能力，以满足下游半导体产业日益增长的市场需求，是公司响应半导体产业链本土化全链条供给的国家发展战略、助力提升半导体设备及其关键零部件国产化率、支撑半导体产业链安全稳定运行的重要举措。

2、完善公司产品和技术在半导体高端应用领域以及消费电子、汽车、新能源等下游行业的业务布局，提升全流程生产能力，筑牢公司核心竞争力

公司长期致力于溅射镀膜、蒸发镀膜、离子镀膜等真空镀膜技术以及成膜工艺的研究与应用，生产的各类真空镀膜设备已广泛服务于消费电子如智能手机、光学镜头，其他消费品如家居建材、生活用品，工业品如半导体、航空等领域，前述行业在产业结构性升级过程中对产能更大、自动化水平更高、生产效率和成本更具优势的连续式生产设备需求将不断增加。本次募集资金拟投向的“超精密半导体及连续式PVD设备产业化项目”与公司现有核心技术、应用领域具备高度关联性，是公司PVD设备在镀膜厚度、控制精度、环境真空度等参数指标的优化与升级，是适配下游半导体领域客户需求以及其他下游客户连续式生产应用场景的重要举措，本次募投项目实施后将进一步提高公司在半导体、消费电子、汽车、新能源等下游行业的参与度。

本次募投项目拟设计高等级洁净生产车间，并引进自动化生产设备、表面处理等配套设备及管理系统，形成大型腔体精密加工与表面处理能力，满足大型镀膜设备对核心部件精密制造与预处理的需求、打造适配更高精度的PVD设备的生产基地。本次募投项目实施后，公司将提升超精密光学镀膜设备、TGV微孔镀膜设备、连续式镀膜设备等PVD设备的供应能力，促使公司产品优势、技术优势转化为市场竞争优势，丰富公司产品层次和应用领域；充分满足下游客户对更高精度PVD工艺的需求，支持公司开拓并深度绑定下游头部客户资源，保障公司对客户配套服务的响应能力，从而增强公司市场竞争力。

3、增强资金实力、优化财务结构，为公司战略实施与可持续发展提供坚实保障

本次发行募集资金到位后，公司股权资本得以补充，资产负债结构进一步优化，有利于公司提高财务稳健性和抗风险能力。同时，本次募集资金能为公

司技术升级成果的产业化落地和经营效率提升提供资金保障，为公司人才引进、业务拓展等提供持续性支持，有利于公司匹配行业发展诉求，筑牢公司行业地位，为公司未来业绩增长、战略实施提供长效驱动力，后续募投项目效益的逐步释放也将提升公司整体经济效益。此外，补充流动资金亦能满足公司经营规模增长所带来的营运资本需求，为公司可持续发展提供坚实保障。

二、本次发行证券及其品种选择的必要性

（一）本次发行证券的种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）本次发行证券品种选择的必要性

1、满足本次募集资金投资项目的资金需求

本次发行募集资金拟投入应用于半导体、消费电子、汽车、新能源等领域的 PVD 设备产能建设项目及补充流动资金，均围绕公司主营业务领域展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行有利于促进公司主营业务的发展，提升公司的核心竞争力，同时也将提升公司的资金实力，增强公司资产结构稳定性和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益。因此，本次发行对公司经营发展有着积极的战略意义。

由于本次募集资金投资项目所需资金规模较大，若公司全部用自有资金和债权融资投入，将面临较大的资金压力和偿债压力，且会增加较大财务费用支出，同时影响日常业务经营和业务拓展。公司通过本次发行募集资金，能够有效解决本次募集资金投资项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施，同时也有利于公司降低经营风险和财务风险，巩固并提升行业地位和盈利能力。

2、股权融资是适合公司现阶段选择的融资方式

债权融资金额相对有限，且财务成本较高，一方面将导致公司资产负债率攀升，加大公司的财务风险；另一方面较高的利息支出将侵蚀公司整体利润水

平，降低公司资金使用的灵活性，不利于公司实现稳健经营。股权融资具有可规划性和可协调性，能使公司保持稳定资本结构，减少公司未来的偿债压力和资金流出，符合公司长期发展战略。随着募投项目的投产，公司盈利水平将进一步提升，经营业绩的增长可消化股本扩张对即期收益摊薄的影响，为公司全体股东带来良好的回报。公司通过本次发行募集资金，可以进一步夯实公司的资本与净资产规模，有效降低偿债压力，提高经营稳定性与抗风险能力，有利于保障本次募投项目的顺利实施，保持公司资本结构的合理稳定，是适合公司现阶段选择的融资方式。

综上，公司本次向特定对象发行股票募集资金具有必要性和合理性。

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性

（一）本次发行对象的选择范围的适当性

公司本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含本数），包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所相关规定协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

本次所有发行对象均以人民币现金方式、以同一价格认购本次发行的股票。

本次发行对象的选择范围符合《注册管理办法》等有关法律法规的规定，发行对象的选择范围适当。

（二）本次发行对象数量的适当性

公司本次向特定对象发行股票的最终发行对象不超过 35 名（含本数），发行对象的数量符合《注册管理办法》等相关法律法规的规定，发行对象数量适当。

（三）本次发行对象标准的适当性

本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行对象的标准适当。

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

（一）本次发行定价的原则及依据

本次发行股票采取询价发行方式，定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行底价。

本次发行的最终发行价格将在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

本次发行定价的原则及依据符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行定价的原则及依据合理。

（二）本次发行定价的方法和程序

本次向特定对象发行 A 股股票定价方法和程序均根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定，已经董事会审议通过并将相关公告在交易所网站及指定的信息披露媒体上进行披露，尚须经公司股东会审议通过、深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。

本次发行定价的方法及程序符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行定价的方法和程序具备合理性。

综上，本次发行定价的原则、依据、方法和程序均符合相关法律法规的要求，合规合理。

五、本次发行方式的可行性

本次发行采用向特定对象发行方式，经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，在注册批复的有效期限内择机向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行。

（一）本次发行方式合法合规

1、本次发行符合《公司法》的相关规定

（1）本次发行的股票为人民币普通股股票，每股面值 1.00 元，每一股份具有同等权利；每股的发行条件和发行价格相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额，符合《公司法》第一百四十三条的规定。

（2）本次发行股票的价格超过每股人民币 1.00 元的票面金额，符合《公司法》第一百四十八条的规定。

2、本次发行符合《证券法》的相关规定

（1）本次发行符合《证券法》第九条的相关规定：“非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。”

（2）本次发行符合《证券法》第十二条的相关规定：“上市公司发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理

办法由国务院证券监督管理机构规定。”

3、本次发行符合《注册管理办法》的相关规定

(1) 公司不存在《注册管理办法》第十一条关于上市公司不得向特定对象发行股票的相关情形：

①擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；

②最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

③现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

④上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

⑤控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

⑥最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

(2) 公司本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的相关规定：

①符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

②除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

③募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公

司生产经营的独立性。

(3) 公司本次发行的发行对象、发行定价符合《注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条的相关规定

本次发行对象、发行定价的具体约定和符合上述规定的详细说明详见本报告“三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性”、“四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性”。

(4) 本次发行的限售期符合《注册管理办法》第五十九条的规定

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，符合《注册管理办法》第五十九条的相关规定。

(5) 本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定

本次发行，公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形，符合《注册管理办法》第六十六条的相关规定。

4、本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）的相关规定

(1) 关于《注册管理办法》第九条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的理解与适用规定

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》关于财务性投资相关要求，截至最近一期末，公司不存在金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项和委托理财等财务性投资的情形，符合相关规定。

(2) 关于《注册管理办法》第十条“严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为”、第十一条“严重损害上市公司利益

或者投资者合法权益的重大违法行为”和“严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为”的理解与适用规定

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》关于重大违法行为的认定标准以及严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的判断标准的界定，上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，符合相关规定。

(3) 关于《注册管理办法》第四十条“理性融资，合理确定融资规模”的理解与适用规定。

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》关于“理性融资，合理确定融资规模”的理解与适用规定，公司本次发行拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的百分之三十，公司前次募集资金到位日为 2024 年 5 月 30 日，本次发行董事会决议日为 2026 年 8 月 10 日，相应融资间隔时间超过 18 个月，符合“理性融资，合理确定融资规模”的相关规定。

(4) 关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条“主要投向主业”的理解与适用规定

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》关于“主要投向主业”的理解与适用规定，本次发行采用向特定股东发行股票方式，募集资金总额不超过 95,500.00 万元，扣除发行费用后拟投入应用于半导体、消费电子、汽车、新能源等领域的 PVD 设备产能建设项目及补充流动资金，投向均围绕公司主营业务展开，有利于提升公司的市场竞争力和抗风险能力，且用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的 30%，符合“主要投向主业”的相关规定。

5、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩戒的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业

经查询，公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩戒的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业。

（二）确定发行方式的审议程序合法合规

公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，董事会决议以及相关文件已在中国证监会指定信息披露网站及指定的信息披露媒体上进行披露，履行了必要的审议程序和信息披露程序。

本次发行方案尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

综上，公司不存在不得发行证券的情形，本次发行符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行方式亦符合相关法律法规的要求，审议程序及发行方式合法、合规、可行。

六、本次发行方案的公平性、合理性

本次发行方案已经公司第三届董事会第八次会议审慎研究后审议通过，考虑了公司目前所处的行业现状、未来发展趋势以及公司的发展战略，发行方案的实施将有利于公司持续稳定的发展，有利于增加全体股东的权益，符合全体股东的利益。

本次向特定对象发行方案及相关文件已在深交所网站及指定信息披露媒体上进行披露，保证了全体股东的知情权。

公司将召开审议本次发行方案的股东会，股东将对公司本次发行按照同股同权的方式进行公平的表决。股东会就本次发行相关事项作出决议，必须经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况将单独计票。公司股东可通过现场或网络表决的方式行使股东权利。

本次发行完成后，公司将及时披露发行股票发行情况报告书，就本次发行股票的最终发行情况作出明确说明，确保全体股东的知情权与参与权，保证本次发行的公平性及合理性。

综上所述，本次向特定对象发行方案已经过董事会审慎研究，认为该发行方案符合全体股东利益；本次向特定对象发行方案及相关文件已履行了相关披露程序，保障了股东的知情权。本次发行方案将在股东会上接受参会股东的公

平表决，具备公平性与合理性。

七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司分析了本次发行对即期回报可能造成的影响，并结合公司实际情况，提出了相关具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

上述具体内容，详见公司同日披露的《广东汇成真空科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

八、结论

综上所述，公司本次发行具备必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，本次发行方案的实施符合公司发展战略，有利于进一步提高公司抗风险能力和可持续盈利能力，有利于公司长期、持续、健康发展，符合公司及全体股东利益。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日